

...the broadest narrowband money can buy



Osazování desek plošných spojů

RACOM v roce 2006 přemístil svůj závod na osazování desek plošných spojů v Blansku do nově vybudované provozovny. Při této příležitosti byla výrazně zmodernizována i používaná technologie, která je plně v souladu se směrnicí RoHS. Díky tomu se výrazně zvýšila kapacita a kvalita osazování plošných spojů technologií oboustranné povrchové a smíšené montáže.

Volnou kapacitu našich nejmodernějších linek vhodných pro realizaci vzorků i pro sériovou produkci tak můžeme nabídnout k využití i dalším firmám.



Technologie a služby

- **Nanášení pájecí pasty a lepidel** tiskem přes kvalitní kovové leptané šablony na síťotiskovém zařízení SIGMAPRINT firmy SMTECH s velkým rozsahem nastavitelných parametrů.
- **Automatické osazování** na automatech MYDATA s více než 190 zakládacími pozicemi, optickým naváděním a centrováním, mechanickou a elektrickou kontrolou součástek s rychlostí osazování až 16 000 součástek za hodinu.
- **Reflow pájení**, resp. vytvrzování lepidla v osmizónové horkovzdušné peci HELLER s možností precizního nastavení přetavovacího profilu.
- **Pájení na vlně** lepených SMD součástek nebo vývodových součástek olovnatou nebo bezolvnatou pájkou na zařízeních firmy SEHO vybavených nástřikovým fluxerem a systémem dvojité vlny.
- **Ruční osazování** klasických součástek a nestandardních SMD součástek na pracovištích s tvarovacím zařízením a manipulátory.
- **Kontrola** – speciální pracoviště a zařízení pro mezioperační a výstupní kontroly včetně optické inspekce.
- **Doplňkové služby:**
 - technicko-technologické konzultace
 - zajištění dodávek součástek pro osazování včetně DPS
 - opravy osazených DPS
 - realizace nestandardních technologií...

